

合肥晶合集成电路股份有限公司

2024 年年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

1、经合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现营业收入 902,000.00 万元到 947,000.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，增加 177,645.86 万元到 222,645.86 万元，同比上升 24.52%到 30.74%。

2、预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润 45,500.00 万元到 59,000.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，增加 24,337.09 万元到 37,837.09 万元，同比上升 115.00%到 178.79%。

3、预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 34,000.00 万元到 44,000.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，增加 29,287.05 万元到 39,287.05 万元，同比上升 621.42%到 833.60%。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

2023 年公司实现营业收入 724,354.14 万元；实现归属于母公司所有者的净利润 21,162.91 万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 4,712.95 万元。

三、本期业绩变化的主要原因

1、报告期内，随着行业景气度逐渐回升，公司整体产能利用率维持高位水平，助益公司营业收入和产品毛利水平稳步提升。

2、公司紧跟行业内外业态发展趋势，在巩固现有产品的情况下，持续扩大应用领域及开发高阶产品，提升产品竞争优势及多元化程度。经财务部门初步测算，公司主要产品 DDIC、CIS、PMIC、MCU 占主营业务收入的比例分别约为 67.53%、17.22%、8.80%、2.47%，DDIC 继续巩固优势，CIS 成为公司第二大主轴产品，其他产品竞争力持续稳步增强。

3、公司高度重视研发体系建设，持续增加研发投入。目前 55nm 中高阶单芯片及堆栈式 CIS 芯片工艺平台已大批量生产，40nm 高压 OLED 芯片工艺平台已实现小批量生产，28nm 逻辑芯片通过功能性验证。公司将加强与战略客户的合作，加快推进 OLED 产品的量产和 CIS 等高阶产品开发。

四、风险提示

本次业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司目前不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2024 年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2025 年 1 月 22 日